

# ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: **0522**)

# 二零零六年未經審核中期業績公佈截至二零零六年六月三十日止六個月

#### ASM 於二零零六年上半年創造超卓成績

- 營業額創新紀錄達2.93億美元
- 純利亦創新高,達港幣6.25億元,每股溢利為港幣1.61元
- 現金結存歷來最高,於本期末達港幣8.74億元
- 穩佔全球裝嵌及包裝設備業第一位
- 引線框架業務連續五季創新營業額紀錄

ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED 董事會欣然宣佈如下:

# 業績

謹此欣然報告,ASM Pacific Technology Limited 及其附屬公司(「集團」或「ASM」)於截至二零零六年六月三十日止六個月之營業額創新紀錄,錄得港幣2,273,105,000元,較去年同期的港幣1,457,183,000元增長56.0%,亦較前六個月之港幣2,079,672,000元增加9.3%。期內,集團綜合除稅後溢利同樣刷新紀錄,錄得港幣625,044,000元,較二零零五年同期增加93.2%,亦較前六個月增長18.6%。期內每股基本溢利為港幣1.61元,同為歷來新高(二零零五年上半年:港幣0.84元)。

# 派息

鑑於集團擁有充裕的流動資金及穩步增加的股本基礎,董事會現建議派發中期股息每股港幣0.70元(二零零五年:港幣0.50元)及特別股息每股港幣0.75元(二零零五年:港幣0.20元)。此派息政策乃貫徹集團於過去數次業績公佈時明確指出將剩餘現金回饋予股東的審慎政策,並預留適量的股東資金作營運之用。憑藉過去數年在微電子市場所建立的穩固基礎,集團未來不僅致力透過其多元化及高性能的產品擴大市場佔有率,積極加快本體增長,還會開發具高利潤增長的新市場。集團在短期內沒有重大現金開支,並於過去十年持續從營運產生顯著正現金流量。

集團將於二零零六年八月十七日至八月二十四日,包括首尾兩天,暫停辦理股份過戶登記手續。為確保獲派是次中期及特別股息,所有股票過戶文件連同有關股票須於二零零六年八月十六日下午四時前,送達香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓公司股份登記處秘書商業服務有限公司。中期及特別股息將於二零零六年八月二十九日左右派發。

# 簡明綜合收益報表

		截至六月三十日止六個月	
		二零零六年	二零零五年
		(未經審核)	(未經審核)
	附註	港幣千元	港幣千元
營業額	1	2,273,105	1,457,183
銷貨成本		(1,207,854)	(802,860)
毛利		1,065,251	654,323
其他收益		17,328	13,077
銷售費用		(182,008)	(138,812)
一般管理費用		(86,786)	(64,848)
研究及發展支出		(138,097)	(119,015)
財務費用		(27)	(3)
除税前溢利		675,661	344,722
所得税開支	3	(50,617)	(21,131)
本期間溢利		625,044	323,591
已派付股息	4	503,177	404,532
每股溢利	5		
一基本		港幣1.61元 —————	港幣0.84元
— 攤薄		港幣1.61元	港幣0.84元
- · · · · ·			

# 簡明綜合資產負債表

	二零零六年 六月三十日 (未經審核) <i>港幣千元</i>	二零零五年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
<b>非流動資產</b> 物業、廠房及設備	799,697	808,030
預付租賃費用 遞延税項資產	8,987 659	8,951 118
	809,343	817,099
流動資產	/// <b>=</b> 00	(00.245
存貨 貿易及其他應收賬款	666,708	609,345
頁勿及其他應收販款 預付租賃費用	1,047,626 461	892,255 448
銀行結餘及現金	874,434	728,927
	2,589,229	2,230,975
<b>流動負債</b> 貿易及其他應付賬款	742,764	585,020
應付税項	99,302	66,101
應付銀行票據	1,544	462
	843,610	651,583
流動資產淨值	1,745,619	1,579,392
	2,554,962	2,396,491
資本及儲備		
股本	38,706	38,706
股息儲備	561,236	503,177
其他儲備	1,951,997	1,851,651
本公司權益持有人應佔權益	2,551,939	2,393,534
<b>非流動負債</b> 遞延税項負債	3,023	2,957
	<u> </u>	<u>·</u>
	2,554,962	2,396,491

# 附註:

#### 1. 分類資料

#### 業務分類

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年 (未經審核) <i>港幣千元</i>	二零零五年 (未經審核) 港幣千元
營業額		
設備	1,805,701	1,173,650
引線框架	467,404	283,533
	2,273,105	1,457,183
業績		
設備	570,307	301,406
引線框架	90,002	35,644
	660,309	337,050
利息收入	15,379	7,675
財務費用	(27)	(3)
除税前溢利	675,661	344,722
所得税開支	(50,617)	(21,131)
本期間溢利	625,044	323,591

### 營業額 截至六月三十日止六個月

	二零零六年 (未經審核) <i>港幣千元</i>	二零零五年 (未經審核) 港幣千元
中國大陸	587,231	335,226
台灣	412,464	265,313
馬來西亞	381,592	188,441
泰國	202,050	96,482
香港	166,053	118,974
韓國	138,318	122,187
菲律賓	102,773	93,198
美國及拉丁美洲	78,994	62,911
新加坡	68,794	69,357
歐洲	61,243	75,151
日本	47,630	17,985
印尼	22,363	9,683
其他	3,600	2,275
	2,273,105	1,457,183

#### 2. 折舊

於本期間內,計入集團損益的物業、廠房及設備之折舊為港幣8,240萬元(二零零五年六月三十日止六個月:港幣7,440萬元)。

#### 3. 所得税開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年	二零零五年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
税項包括:		
香港利得税	45,136	15,254
在其他司法權區之税項	5,952	4,489
	51,088	19,743
遞延税項(抵免)支出	(471)	1,388
	50,617	21,131

香港利得税是按本期間內估計應課税溢利以税率17.5%(二零零五年六月三十日止六個月為17.5%)計算。

其他司法權區之税項乃根據有關司法權區個別之現行税率計算。

集團新加坡分部獲當地政府頒發「生產總部」榮譽,根據新加坡稅務當局授與之稅務獎勵計劃,本集團在新加坡生產之若干半導體設備及物料新產品所產生之溢利毋須課稅,自二零零一年一月一日起十年內,在新加坡分部履行若干條件下,該等優惠將為有效。

集團於中華人民共和國經營之部分附屬公司從首個獲利年度起豁免兩年所得稅,其後三年可減半。

遞延税項(抵免)支出主要是來自税項折舊與計入財務報表之折舊費用之暫時性差距的税務影響。

#### 4. 已派付股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年 (未經審核)	二零零五年 (未經審核)
	港幣千元	港幣千元
二零零五年第二次特別股息每股港幣0.30元 (二零零四年:無)派發予387,059,500股	116,118	_
二零零五年末期股息每股港幣1.00元 (二零零四年:港幣1.05元)派發予387,059,500股		
(二零零四年: 385,268,500股)	387,059	404,532
	503,177	404,532
建議中期股息每股港幣0.70元		
(二零零五年:港幣0.50元)派發予387,059,500股		
(二零零五年: 385,268,500股)	270,942	192,634
建議特別股息每股港幣0.75元		
(二零零五年: 港幣0.20元)派發予387,059,500股 (二零零五年: 385,268,500股)	290,294	77,054
(一々々五十・ 363,206,300以)		
	561,236	269,688

股息將派發予於二零零六年八月十七日名列本公司股東名冊上之股東。

#### 5. 每股溢利

每股基本及攤薄溢利按以下數據計算:

截至六月三十日止六個月

二零零五年 二零零六年 (未經審核) (未經審核)

港幣千元

港幣千元

計算每股基本及攤薄溢利之股東應佔溢利

625,044

323,591

股份之數量(以千位計)

計算每股基本溢利之普通股加權平均股數 來自僱員股份獎勵制度之潛在攤薄影響

387,060 608 385,269

1.263

計算每股攤薄溢利之普通股加權平均股數

387,668

386,532

# 業務回顧

全球經濟持續蓬勃發展促使強勁的消費意欲,尤其是手提電話、數碼相機、MP3 機及 數碼電視等產品。此外,隨著電腦及遊戲市場的需求穩步上揚,加上電子產品在日常生 活越來越普及,為提升功能及性能,電子產品不斷增加其半導體成份,因而使全球市場 對半導體的需求於過去數月迅速增長。大部分專家均調高其市場前景預測,較其六個月 前所作的預測高約2%。根據分析員如美國半導體行業協會 (SIA)、Dataquest、VLSI Research、WSTS 及 IC Insights 的最新預測顯示,全球半導體業預測將會於2006年增長8 -10% °

鑑於半導體市場對與產能相關的設備之需求增加,以及市場對高性能、多元化功能、低 成本及產品體積的需求,令各應用市場對半導體裝嵌及包裝設備的需求大增。此外,越 來越多的集成電路組合在設計上均配備更微細的管線闊度、晶積度尺寸 (OFN) 及晶片 大小(覆晶)、多層管芯、多層包裝 (PoP) 及組裝系統 (SiP),令市場對新一代裝嵌設備 的需求更加殷切。業界的訂貨付運比率於過去數月輕微高於一,顯示行業平穩發展,尤 其是對集團這多元化生產設備供應商而言。

承接近年的卓越表現,本年度 ASM 再度超越同儕並提升市場佔有率,自二零零二年起 穩佔裝嵌包裝設備行業的第一位。於過去六個月,集團的營業額及純利均創新紀錄,分 別達2.93億美元及港幣6.25億元。資本回報率及銷售利潤率分別為26.5%及29.0%。儘管我 們在第二季及過去的六個月錄得創紀錄的付運量,然而由於同期的訂單數目強勁,首六 個月的訂貨付運比率為1.17,而於二零零六年六月三十日未完成訂單總值逾1.53億美元(於 二零零五年十二月三十一日為1.02億美元)。

ASM 再度創佳績,刷新歷來的優異紀錄,實有賴集團多年來透過產品及應用市場多元 化策略、建立有效的成本結構及成功推出具備先進技術的新產品,成功奠定穩固基礎。 於二零零六年上半年,我們的五大客戶共佔集團營業額23.8%,所有客戶的銷售額佔集團

營業額均不超過10%,足以證明我們的市場多元化策略之成功。此外,集團的銷售廣泛分佈各地,當中中國大陸仍然是集團最主要的市場(25.8%),台灣(18.2%)及馬來西亞(16.8%)緊隨其後,足以反映業內的投資氣候。

集團近年的優秀業績表現充分反映旗下產品備受廣大客戶認同。於二零零六年上半年,集團設備業務的收益為2.328億美元,佔集團營業額79.4%,並超越了二零零零年創下的紀錄。受惠於市場需求增加、集團的市場佔有率上升及中國和馬來西亞的廠房產能擴充,集團引線框架業務的營業額連續五季創新高。於二零零六年上半年,引線框架業務的收益為6,030萬美元,佔集團營業額20.6%,較前六個月增長20%,顯示集團就引線框架業務所作出的策略性調整已取得成效。隨著集團於馬來西亞的新廠房今年完成調整階段,預計將進一步提升集團的成本效益和 QFN 浸蝕框架的產量。

從我們主要競爭對手公佈的集團收益,ASM 持續提升市場佔有率及穩定的營業額增長看來,集團管理層相信旗下的管芯焊機於過去十二個月的銷量已超越全球的競爭對手。憑藉其創新意念及無可比擬的成本效益,我們的雙頭金線焊線機,讓 ASM 藉推出競爭對手不能媲美的產品,進一步擴大其客戶基礎。憑藉集團精良的研發隊伍及低成本生產能力,我們高靈活性的 Osprey 塑封工序設備系統,深受新客戶及現有客戶的歡迎,令這市場唯一獨有的新產品獲一致好評。此外,Osprey 塑封工序設備系統還榮獲 Semiconductor International 雜誌選為二零零六年度編輯之選的最佳產品,以表揚其具備高靈活性及模具投資保障的獨特功能,並為客戶帶來多元化價值。同時,集團的影像感應組件乃採用藍海策略 (Blue-Ocean-Strategy) 的另一產品,並成功為集團締造全新市場,毋須與其他產品直接競爭。集團這全方位粒子感應應用令 ASM 於該應用市場享有無可替代的市場地位。

為滿足現今客戶對多元化包裝種類及應用的需求,適用於任何裝嵌工序的複合應用平台亦應運而生,包括集團的金線焊線機、管芯焊接機、鋁線焊接機、覆晶焊接機、LED晶片分類機、塑封系統、包裝切割系統及測試處理產品。由於我們需在短的交貨期內為客戶生產標準產品,因此更廣闊的產品、更快的生產率、複合平台及引入新產品等綜合影響,使集團的半製成品和原料存貨量相對前六個月有所增加。此外,原材料數量亦隨著客戶訂單上升而有所增加,令集團於二零零六年六月三十日期末的存貨微升至港幣6.667億元(於二零零五年十二月三十一日為港幣6.093億元),年度化之存貨周轉率因受更高收益的正面影響,為7.13(二零零五年:6.08)。此外,集團積極落實應收賬款管理,使平均收賬期降至78.2日(二零零五年:88.2日)。集團完善的營運資金管理,令集團錄得自由現金流量 (Free Cash Flow) 為港幣5.643億元,而過去六個月的投入資本回報率則為35.2%。

在二零零六年四月派發上年度末期股息及第二次特別股息共港幣5.032億元、及支付二零零六年上半年的資本性投資港幣6,860萬元後,鑑於期內正現金流量強勁,集團於二零零六年六月三十日的現金結存達港幣8.744億元,較前六個月高出港幣1.455億元,創出 ASM 六個月期末的新紀錄。集團流動比率維持在3.07水平,並沒有長期借貸及銀行貸款,股本負債比率亦僅為33.2%。由於集團短期內沒有重大現金開支,並從營運活動持續產生正現金流量,ASM 管理層建議持續派發高息以回饋剩餘現金予集團的股東。

## 展望

由於消費者應用半導體之銷售遠超越企業應用之銷售,故晶片行業未來的發展將更受全球宏觀經濟及消費市場所影響。根據市場展望,大部分行業分析員均預測二零零六年將錄得8-10%的增長。此外,SIA、WSTS及 iSuppli 亦預測半導體行業於二零零七年將繼續11-12%的增長。根據二零零五年電子時報 (Electronic Trend Publication)預測,集成電路產量於二零零四至二零零九年期間的複合年增長率將達9.31%。

至於裝嵌設備市場方面,多個行業的分析員六個月前作出的未來增長預測甚為參差,介乎3.6-22.1% (VLSI Research — 3.6%; SEMI — 9.0%; Dataquest — 22.1%),而目前的預測則較一致,預期將有雙位數字的增長,介乎11.7-19.0% (SEMI — 11.7%; Dataquest — 17.5%; VLSI Research — 19.0%),反映本年度上半年市況好轉。然而,本年度的實際增長幅度,將視乎市場能否維持首兩季的增長勢頭。

過去三十年間,集成電路包裝形式不斷推陳出新,如孔塑雙列直插式封裝 (DIP)、表面焊接式封裝設備 (SMD)、球柵陣列封裝 (BGA)、覆晶焊接 (FC) 及無針方形扁平封裝 (QFN),並持續提升纖細度,半導體包裝行業因而繼續朝著應用主導裝置及整合已知裝嵌程序的高密度包裝這兩個主要方向發展。前者包括為客戶訂造多項應用的包裝解決方案,如智能卡、RFID、感應組件 (如相機組件的 CMOS 影像感應組件)、MEMS、高亮度LED 等等;後者則需要新一代的裝嵌系統,並以傳統裝嵌程序為基礎,利用科技進行高密度包裝,如多層管芯 (SD)、多層包裝 (PoP)、組裝系統 (SIP) 及多片組件 (MCM)。

要在此瞬息萬變的行業中維持領導地位,管理層相信 ASM 必須同時應付不同應用特性及已知加工技術並存的情況所帶來的挑戰。除了準備新一代的管芯、覆晶、金線和鋁線焊接機,以加強集團在市場的領導地位外,集團同時亦積極投放更多資源開發多晶片管芯焊接及覆晶晶片直接玻璃封裝應用所需的設備,並期望在二零零七年把產品推出市面。集團深信,提供綜合包裝解決方案是最有效的市場推廣策略,而透過銷售其他 ASM 產品予相同客戶達致本體增長,而引入符合藍海策略的產品方是未來數年過渡管理層承接期的合適業務策略。

集團目前取得的成功促使我們制定未來擴展大計。隨著具龐大市場潛力的塑封工序設備系統及測試處理產品漸獲客戶接納,集團需作出策略性的決定。此等產品已準備就緒,隨時推出市場,惟集團必須有更強大的銷售團隊、更短的交貨時間及更多技術服務人員作支援。除此以外,ASM 旗下多元化產品不斷擴大市場佔有率,令集團必須為管芯焊機、焊線機及後工序產品(自動塑封及塑封後工序產品)於未來數年準備充足的生產力。有鑑於此,管理層決定租用集團現位於中國深圳福永廠房鄰近的物業,面積達120,000平方呎,並把後工序產品的整個部件製造及組件組裝程序遷移至此。除積極提升後工序產品的產量外,此舉亦為集團於中國深圳沙頭角廠房的焊線機生產業務提供增長空間。

經過多年來的努力, ASM 累積了豐富的技術經驗及專才。我們傑出的往績亦足以證明集團以客為主導的策略取得成功。來自不同應用市場的廣大客戶基礎、多元化產品選擇及業內最具效益的成本結構均為 ASM 可持續的競爭優勢。此外,集團採取長遠發展策略,即使面對短期銷售波動,集團於過去十年仍然堅持將設備銷售額的10%(即2.346億美

元)投放於研發上,並作出2.463億美元的龐大資本性投資,為 ASM 於全球市場建立更 穩固的地位。儘管爭奪市場佔有率是一項困難的挑戰,但一般而言,擁有豐富資源的競 爭者通常都可獨佔先機。憑藉多方面的實力,管理層深信集團將可繼續超越同儕,維持 市場領導地位。

個人而言,本人自 ASM Pacific Technology Ltd. (ASMPT) 創立以來,帶領集團於過去三十一年不斷發展,並持續錄得盈利,現應是時候為我的人生重訂優先次序。我計劃於二零零六年十二月三十一日正式退休,並在集團董事會及主要股東 ASM International 同意下,擔任集團的榮譽主席至二零零七年六月三十日,協助集團順利過渡。在我任期內取得的優秀紀錄,將會由接棒人打破,我亦深信集團憑著與我並肩作戰二十五年的管理精英,勢將帶領 ASMPT 於未來再創佳績。

# 企業管治

為了確保本公司組織章程細則完全遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四之企業管治常規守則(「企業管治常規守則」)所附載的守則條文,本公司已於二零零六年四月二十四日舉行之二零零六年股東週年大會上,通過一項修改本公司之組織章程細則的特別決議案,規定所有董事均須每三年輪流退任一次,而為填補臨時空缺而被委任的董事,則須於其獲委任後首次股東大會上接受股東投票重選。

截至二零零六年六月三十日止六個月,本公司已遵守所有附載於企業管治常規守則的守則條文。

# 審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事組成,彼等於審計、法律事宜、商業、會計、企業內部監控及監管事務方面擁有豐富經驗。

# 賬目審閱

審核委員會聯同本集團的核數師已審閱集團截至二零零六年六月三十日止六個月期間未經審核的簡明綜合財務報表。

# 購買、出售或贖回本公司的上市證券

於本期間,本公司並無贖回任何其上市證券,本公司及其任何附屬公司於本期間內亦並 無購買或出售本公司之上市證券。

# 董事會

於本公布日期,本公司董事會成員包括: 執行董事 Arthur H.del Prado 先生(主席)、林 師龐先生及馮樹根先生,非執行董事:Arnold J.M.van der Ven 先生,獨立非執行董事:Orasa Livasiri 小姐、鄧冠雄先生及李兆雄先生。

承董事會命 *董事* 林師龐

香港,二零零六年七月三十一日

請同時參閱本公佈於經濟日報/信報刊登的內容。